

60A、60V N沟道增强型场效应管

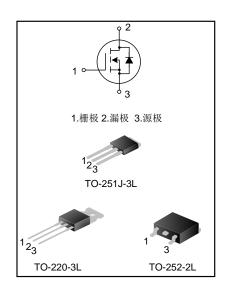
描述

SVT06130NT/D/MJ N沟道增强型功率 MOS 场效应晶体管采用先进的 LVMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于不间断电源及逆变器系统电源管理。

特点

- ◆ 60A, 60V, R_{DS(on)} (典型值) =11mΩ@V_{GS}=10V
- ◆ 低栅极电荷量
- 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



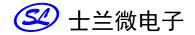
产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包 装
SVT06130NT	TO-220-3L	06130NT	无铅	料管
SVT06130NDTR	TO-252-2L	06130ND	无卤	编带
SVT06130NMJ	TO-251J-3L	06130NMJ	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明, T_c=25°C)

参数名称		符号	参数	24.12	
			SVT06130NT	SVT06130ND/MJ	单位
漏源电压	漏源电压		60		V
栅源电压		V_{GS}	±20		V
T _C =25°C			60		
漏极电流	T _C =100°C	Ι _D	42		А
漏极脉冲电流		I_{DM}	240		А
耗散功率(T _C =25℃)		_	110	90	W
-大于 25°C 每摄氏度减少		P _D	0.88 0.72		W/°C
单脉冲雪崩能量(注 1)		E _{AS}	405		mJ
工作结温范围		T_J	-55∼ + 150		°C
贮存温度范围		T_{stg}	-55∼+150		°C

杭州士兰微电子股份有限公司



热阻特性

62 WL 57 Th	<i>t</i> s/s □	参数	24 /2	
参数名称	符号	SVT06130NT	SVT06130ND/MJ	单位
芯片对管壳热阻	$R_{ heta JC}$	1.14	1.39	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	°C/W

关键特性参数(除非特殊说明, T_c=25°C)

参数	符号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	60			V
漏源漏电流	I _{DSS}	V _{DS} =60V, V _{GS} =0V			1.0	μΑ
栅源漏电流	I _{GSS}	V _{GS} =±20V, V _{DS} =0V			±100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_{D}=250\mu A$	1.1		2.4	V
导通电阻	R _{DS(on)}	V _{GS} =10V, I _D =30A		11	13	mΩ
栅极电阻	R_{G}	f=1MHz		3.5		Ω
输入电容	C _{iss}	f AMULTAN ON		2460		
输出电容	Coss	f=1MHz,V _{GS} =0V,		172		pF
反向传输电容	C_{rss}	V _{DS} =25V		131		
开启延迟时间	t _{d(on)}			16		
开启上升时间	t _r	V_{DD} =30V, V_{GS} =10V, R_{G} =25 Ω , I_{D} =30A		73		
关断延迟时间	$t_{d(off)}$	(注 2,3)		182		ns
关断下降时间	t _f			80		
栅极电荷量	Qg	V 49V V 40V L 60A		52		
栅极-源极电荷量	Q_{gs}	V _{DD} =48V, V _{GS} =10V, I _D =60A (注 2,3)		11		nC
栅极-漏极电荷量	Q_gd	(注 2,3)		12		

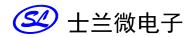
源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	Is	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N		1	60	_
源极脉冲电流	I _{SM}	结			240	Α
源-漏二极管压降	V _{SD}	I _S =60A,V _{GS} =0V			1.3	V
反向恢复时间	T _{rr}	I _S =30A,V _{GS} =0V,		20		ns
反向恢复电荷	Q _{rr}	dIF/dt=100A/µs		0.02		μC

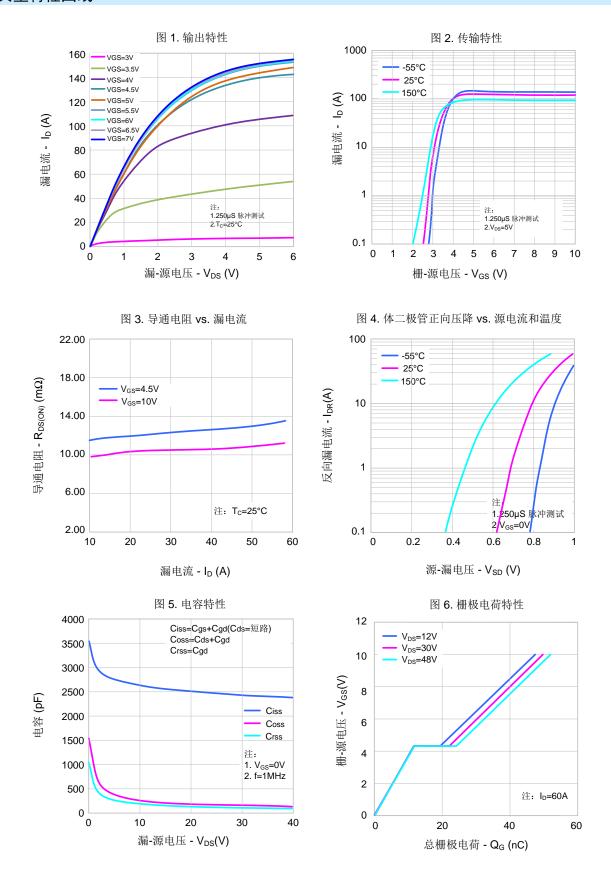
注:

- 1. L=10mH, V_{DD} =50V, R_G =10 Ω , 开始温度 T_J =25°C;
- 2. 脉冲测试: 脉冲宽度≤300µs,占空比≤2%;
- 3. 基本上不受工作温度的影响。

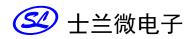
版本号: 1.3



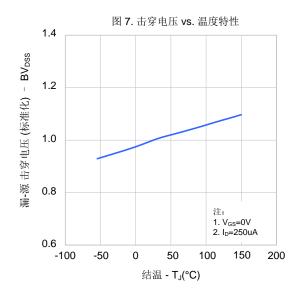
典型特性曲线

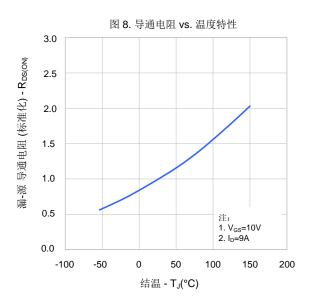


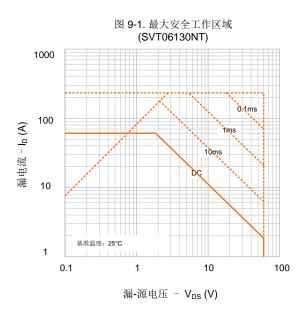
版本号: 1.3 共8页 第3页

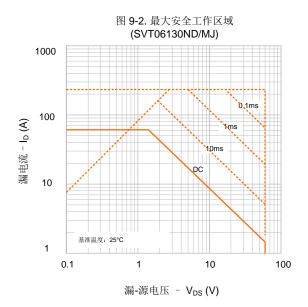


典型特性曲线 (续)

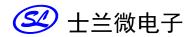






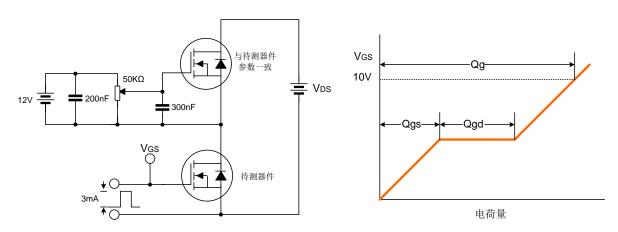


版本号: 1.3 共8页 第4页

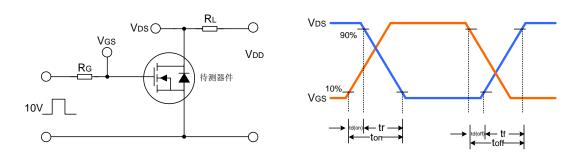


典型测试电路

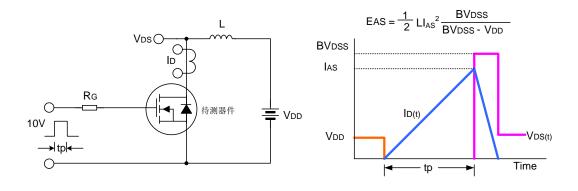
栅极电荷量测试电路及波形图



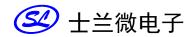
开关时间测试电路及波形图



EAS测试电路及波形图

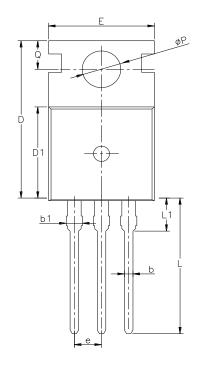


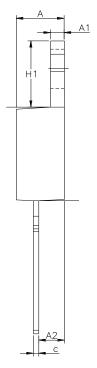
版本号: 1.3 共8页 第5页



封装外形图

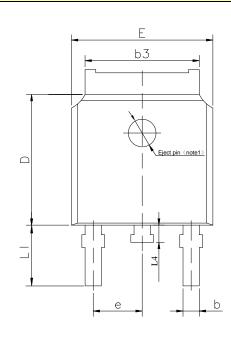
TO-220-3L 单位: 毫米

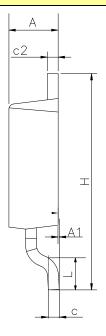




SYMBOL	MIN	NOM	MAX		
Α	4.30	4.50	4.70		
A1	1.00	1.30	1.50		
A2	1.80	2.40	2.80		
Ь	0.60	0.80	1.00		
b1	1.00	_	1.60		
С	0.30	_	0.70		
D	15.10	15.70	16.10		
D1	8.10	9.20	10.00		
E	9.60	9.90	10.40		
е	2.54BSC				
H1	6.10	6.50	7.00		
L	12.60	13.08	13.60		
L1	_	_	3.95		
ΦP	3.40	3.70	3.90		
Q	2.60	_	3.20		

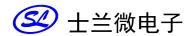
TO-252-2L 单位: 毫米



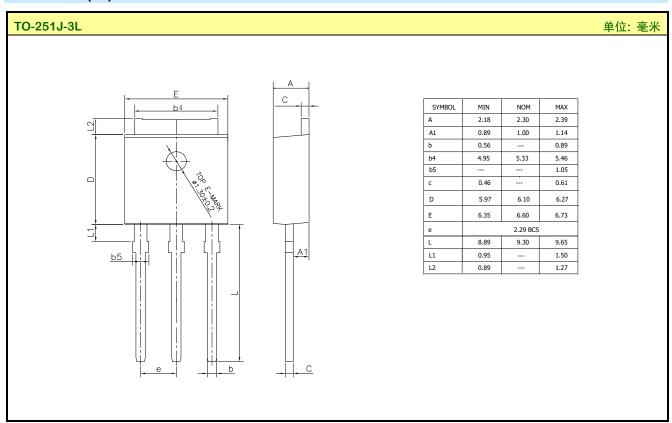


SYMBOL	MIN	NOM	MAX		
A	2.10	2. 30	2. 50		
A1	0		0.127		
b	0.66	0.76	0.89		
b3	5. 10	5. 33	5. 46		
С	0.45		0.65		
c2	0.45		0.65		
D	5. 80	6. 10	6.40		
E	6. 30	6.60	6. 90		
е	2. 30TYP				
Н	9.60	10.10	10.60		
L	1.40	1.50	1.70		
L1	2. 90REF				
L4	0.60	0.80	1.00		

 $\textbf{NOTE1:} \ \text{There are two conditions for this position:} has an eject pin or has no eject pin.$



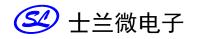
封装外形图(续)



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

版本号: 1.3



SVT06130NT/D/MJ 说明书

产品名称: SVT06130NT/D/MJ 文档类型: 说明书

版 权: 杭州士兰微电子股份有限公司 公司主页: http://www.silan.com.cn

版 本: 1.3

修改记录:

1. 增加 TO-251J-3L 封装外形图

版 本: 1.2

修改记录:

1. 修改 TO-220-3L 封装外形图

版 本: 1.

修改记录:

1. 增加 TO-252-2L 封装

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布

杭州士兰微电子股份有限公司